

Issue Comment

- ✓ 5월 메모리 재고 Peak-out 시작
- ✓ 메모리 선별적 추가 생산 조정 계획
- ✓ HBM 등 고부가 제품 적극적 개발/증설 진행

삼성전자 2Q23 컨퍼런스 콜

Datapoint (QoQ)

디램: B/G 10% 중반 성장, ASP 한자리수 중후반 하락. 3분기 시장 수요 B/G 10% 중반 성장, 삼성전자 시장 수준

낸드: B/G 한자리수 중반 성장, ASP 한자리수 중후반 하락

3분기 시장 수요 B/G 한자리수 중후반 성장, 삼성전자 시장 소폭 상회 예상

디스플레이: 2분기 중소형 비중 90% 후반, 중소형 패널 판매량 한자리수 초반 성장

MX: 스마트폰 판매량 5,300 만대, 태블릿 600 만대. 스마트폰 ASP 269 달러

3분기 전분기 대비 스마트폰 판매량 증가, ASP 상승

TV: 판매량 10% 초반 하락, 3분기 한자리수 후반 성장

삼성전자 2Q23 연결 실적

단위: 조원

	2Q23	1Q23	QoQ %	2Q22	YoY %	SK 증권 예상	차이
매출액	60.0	63.8	6%	77.2	-22%	60.0	0%
DX	40.2	45.9	14%	44.2	-9%	40.5	-1%
VD/CE	14.4	14.1	-2%	14.8	-3%	13.9	4%
MX/NW	25.8	31.8	23%	29.3	-12%	26.6	-3%
DS	14.7	13.7	-7%	28.5	-48%	14.1	5%
SDC	6.5	6.6	2%	7.7	-16%	6.7	-4%
Harman	3.5	3.2	-9%	3.0	17%	3.5	0%
영업이익	0.7	0.6	-4%	14.1	-95%	0.6	11%
DX	3.8	4.1	8%	3.0	29%	3.9	-2%
VD/CE	0.7	0.2	흑전	0.4	106%	0.8	-8%
MX/NW	3.0	3.9	30%	2.6	16%	3.1	-3%
DS	(4.4)	(4.6)	5%	10.0	-144%	(4.4)	적지
SDC	0.8	0.8	-7%	1.1	-21%	0.8	5%
Harman	0.3	0.1	-48%	0.1	149%	0.3	-15%
영업이익률	1%	1%	0%p	18%	-17%p	1%	0%p
DX	10%	9%	1%p	7%	3%p	10%	0%p
VD/CE	5%	1%	4%p	2%	3%p	6%	-1%p
MX/NW	12%	12%	-1%p	9%	3%p	12%	0%p
DS	-30%	-33%	4%p	35%	-65%p	-31%	2%p
SDC	13%	12%	1%p	14%	-1%p	12%	1%p
Harman	7%	4%	3%p	3%	4%p	8%	-1%p

주: 삼성전자, SK 증권 추정

Issue Comment

주요 사업부별 2Q23 및 하반기 전망

	2Q23	2H23 전망
DS		
메모리	데이터센터 중심 보수적 투자 집행 및 고객사 재고 조정 지속 단, 모바일/PC 고객사 재고 건전화 및 고용량화 지속	고객사 재고 감소 전망 속, 점진적 회복 기대 모바일/PC는 세트 빌드 수요 개선 및 가격 탄력성 기반 고용량화 서버는 High-core CPU 전환 확산으로 탑재량 증가 전망 DDR5/LPDDR5x/HBM3 DRAM 확대 QLC NAND 시장 창출, V7/V8 NAND 비중 확대
DRAM	DDR5, 고용량 모듈 수요 기대 속 모바일 하이엔드형 LPDDR5x 적극 대응	
NAND	고용량 수요 적극 대응 기초 하, 모바일 QLC 시장 창출	
LSI	고객사 재고 감축 효과로 전분기 대비 소폭 실적 개선 예상	고객사 부품 재고 소진 및 중국 내수 활성화로 모바일 수요 회복 예상 모바일 SoC 플래그십 재진입 추진. 지문 인증 신용카드도 영역 확대
Foundry	AMD와 그래픽 IP 분야 전략 파트너십 통한 모바일 SoC GPU 경쟁력 강화 고객사 재고 건전화에 따른 수요 회복으로 실적 소폭 개선 전망 2나노 설계 기초 인프라 개발 순항 중. 8x HBM3 25D PKG 개발 완료 생성형 AI 향 제품 지원 기반 확보	HPC/Auto 중심 시장 회복 기대. 실적 반등 전망 3나노 2세대 안정적 개발 토대로 신규 고객 수주 확대 모바일, Auto, HPC, IoT 향 스펙셜티 및 성숙 공정 개발
SDC		
중소형	계절 비수기 예상. 하반기 예정 주요 고객 신제품 출시 대응	OLED 본격 시장 확대 계획. 노트북, 태블릿, Auto 향 침투 추진
대형	수요 위축 예상. 다만 신제품 출시 본격화로 판매 증가 예상	QD-OLED 신제품 출시 본격화, 프리미엄 시장 내 입지 확대 추진
MX/NW		
MX	시장, 중저가 중심 수요 회복. 전분기대비 수량 소폭 상승, 금액은 감소 S23 시리즈 견조한 판매 지속, 폴더블은 Re-boost 마케팅, A 시리즈는 스펙 상향, 프리미엄 경험 강화 신제품 중심 Sell-out	시장, 소비력 회복으로 스마트폰 수량/금액 성장 전망 프리미엄 성장, 태블릿 및 웨어러블은 성장 모멘텀 둔화 폴더블 차별화, S23 Sustain 마케팅/A 시리즈 파트너 협업으로 M/S 제고
NW	국내/북미 등 사업기반 강화, 신규사업 대응 지속	5G 핵심칩, vRAN 등 기술 리더십 지속 강화
VD/CE		
VD	시장, TV 수요 역성장세 완화 및 프리미엄 제품 수요 성장 전망 신모델 런칭 기반 프리미엄 제품 확대, 비용 관리 지속	시장, 성수기로 TV 수요 회복 전망되나 불확실성 지속 및 경쟁 심화 예상 98", Micro LED 라인업 확대 통한 프리미엄/초대형 시장 선도
CE	성수기 진입으로 에어콘 중심 확판, BESPOKE 등 고부가 중심 판매	SmartThings 활용 통한 경쟁력 강화, 성수기 패키지 판매 활성화

주: 삼성전자, SK증권

Capex

2Q23 14.5조원, DS 13.5조원, SDC 0.6조원

1H23 25.3조원, DS 23.2조원, SDC 0.9조원

메모리: 평택 3기 마감, 4기 골조 투자 및 선단 공정 수요 대응 위한 평택 중심 설비 투자 진행

미래 경쟁력 강화 위해 R&D, Back-end 투자 지속

파운드리: 선단공정 위한 테일러, 평택 중심 투자 지속

디스플레이: 중소형 모듈 보완, 인프라 투자 집행

Q&A

Q1) 하반기 메모리 수요와 공급 전망

상반기 고객사 재고 조정으로 가격 하락. 다만 고객사 재고 조정 상당부분 진행

2 분기는 1 분기 대비 가격 하락 폭 확연히 둔화

상반기 세트 수요 부진 지속되었지만, 하반기는 상대적으로 재고 조정 진전 된 PC, 모바일 위주 수요 개선 전망
공급 측면에서도 업계 감산 폭 확대로 하반기 중 일부 시장 변화가 있을 것으로 예상

디램은 TSV와 HKMG 등 특수 공정 적용 제품은 캐파 제약 대비 수요 증가로 타 제품보다 선행 해 가격 반등 예상
낸드는 시장 변화 시점이 디램보다는 후행할 것

Q) OLED 특허 소송 관련 입장

경쟁 업체와의 OLED IP 소송 특허 침해 소송이 미국, 중국에서 진행

처음 시장 개척하고 발전할 때 까지 세상에 없던 기술에 도전했고, 혁신기술

많은 시간, 인력, 자금 투입. 특허 등록 통해 회사 자산으로 엄격히 보호하고 있음

다만 최근 경쟁 본격화되면서 우리 기술의 근간인 지적 자산에 대한 도용 등 침해 행위가 늘어나고 있어 법적 제재 등 다양한 방안 강구 중

Q) 2 분기 메모리 감산 현황과 하반기 생산 전략 및 재고 전망

상반기 재고는 높은 수준으로 마감. 다만 생산량 하향으로 디램, 낸드 재고 5 월 Peak 이후 빠르게 감소 중

하반기 감산 지속, 재고 정상화 위해 디램, 낸드 공히 제품 선별적 생산 조정할 것. 특히 낸드 생산 추가 조정이 클 것

하반기 수익성 중심 시장 대응 강화. HBM, D5, LP5X, PCIe Gen 5, UFS 4.0 등 고부가 제품 확대로 질적 개선할 것

D1a, V7 등 선단공정 판매 확대와 레거시 감산으로 효과 뚜렷하게 나타날 것

Q) 23년 폴더블 시장 전망 및 신제품 확판 전략

선도적으로 폴더블 개척. 경쟁력 시장에서 높은 평가. 플래그십 성장의 새로운 동력으로 키워갈 것
23년 성장세 지속. 플래그십 시장 내 비중도 지속 확대 예상
더 커진 커버스크린, 슬림화, 폼팩터 특화 경험도 강화. 후면 카메라 활용해 다양한 각도로 고화질 셀피 가능
플렉스 윈도우로 개성 표현, 다양한 태스크를 빠르게 편리하게 처리할 수 있음
폴드 5는 플렉스 힌지 적용해 더 얇고, 가벼워 짐. 고성능 AP 탑재해 발열 제어, 소프트웨어 최적화
거래선과의 마케팅 협업 강화해 출시 초부터 확실한 판매 호조 이끌 것

Q) HBM 시장 전망과 대응 전략

대규모 데이터 처리 지원하는 고성능 메모리, 특히 HBM 수요 빠르게 증가 예상
HBM 수요는 중장기 관점 향후 5년간 30% 중후반 성장 기대
단기적으로 하이퍼 스케일러들의 경쟁 심화로 다수 고객들 수요 접수 중. 23, 24년 가파른 수요 성장 기대

HBM 사업 확대 중. HBM 시장 선도업체로 HBM2를 주요 고객에 독점 공급했고, HBM2e도 원활히 진행 중
3도 업계 최고 수준의 성능과 용량으로 진행. 8단 16GB, 12단 24GB 제품을 주요 SoC 업체와 클라우드 업체로 출하 시작.
HBM3P 제품은 24Gb 기반으로 하반기 출시 예정. 업계 최고 수준의 성능, 용량으로 대응할 것

HBM 시장 내 메이저 공급 업체로 지속적 투자를 바탕으로 업계 최고 수준의 생산능력 유지. 올해 10억 Gb 중반을 넘어서
는 고객 수요 확보했고, 하반기 추가 수주를 위한 공급 역량 확대 중
공급 능력 지속 확대. 24년 Capa는 증설 투자를 통해 23년 대비 최소 2배 이상. 향후 수요 변화에 따라 추가 대응할 것

Q) AI 컴퓨팅에서 로직, 첨단 패키지 대응 전략

생성 AI 영향으로 CPU, GPU, AI 가속기 등 AI 칩 수요 향후 5년간 고속 성장할 것

병렬구조의 칩은 고성능, 높은 에너지 효율 매우 중요. 작년 최초 양산 성공한 GAA 는 고성능, 높은 에너지 효율을 요구하는 AI 칩에 최적화. 25년 2 나노 양산으로 AI 칩 시장 선도할 것

AI 칩은 HBM 메모리와 하나의 칩으로 패키징 되고있음. 이를 가능하게 하는 기술과 캐파가 점점 중요해지는 상황
고객들은 하나의 업체에 맡기고 싶어함. 우리는 GAA, HBM, 어드밴스드 패키징 기술 모두 보유하고 있음

강점 극대화 위해 EDA, IP, 기판, 테스트 분야의 생태계 파트너들과 멀티다이인티그레이션 얼라이언스 출범
원스탑, 올인원 서비스를 적시에 제공할 것

Q) HBM 후공정 관련 TC-NCF 기술의 장점

HBM은 수직으로 디램 칩 적층하고 TSV로 연결. 연결 위해 마이크로범프를 사용. 마이크로범프 간 갭을 채우는게 중요
독자적으로 개발한 NCF 기술은 필름을 사용해 갭을 채움. 갭 내 Void 없고, TC 공정 또한 다년간 양산해 수율과 품질에 문제
없음이 검증된 기술. 또한 특성 개선된 최첨단 NCF를 새로 개발해 현재 양산 중인 HBM3에 적용 중

성능 측면에서도 고속 동작하는 HBM 특성 상 열을 잘 방출하도록 칩 간극 줄여야 함. NCF는 여기에 효과적
12단 HBM에서 스택 칩 간격 줄이고, 열 방출에 우수한 7마이크로 기술을 세계 최초로 적용해 양산 중
생산성에서도 NCF는 솔더 표면에 산화막 제거 기능 포함되어있어 본딩 시 사용되는 세정, 가열 공정 불필요
8단 제품에서도 충분한 경쟁력 갖춘 생산성 확보

24년부터 증가하는 12단 제품은 스택 수 증가에 따른 칩 두께 감소로 인해 칩 휘어짐에 기인한 기술 문제 발생 가능
다만 우리 NCF 기능은 열과 하중으로 칩 전면에서 사용돼 상대적으로 휘어짐 용이하게 제어 가능

미래 HBM 제품 두께 제약 필요한 HBM4 16단 초고용량 제품에서도 칩 사이 공간 없애는 기술 개발 중

Q) 이매진 인수 후 마이크로디스플레이 전략

5 월 2900 억 투자해 마이크로디스플레이 업체인 이매진 인수 계약 체결. 기업 결합 및 각국 승인 절차 진행 중. 연말 중 작업 마무리 될 전망. 인수 목적은 XR 디바이스 시장에 대한 대응력 높이기 위함
XR 생태계 빠르게 확대 중. 대중화되면, 스마트폰 이상으로 일상에 변화를 줄 것으로 전망

01년부터 마이크로디스플레이 개발한 업체. 초고상도 올레도스에 필요한 원천 특허 보유
우리 역시 작년부터 전장 개발팀 구성해 올레도스, 레도스 등 차세대 마이크로 디스플레이 개발에 집중
다양하게 기술 센싱 해 투자 및 협력 지속 해 나갈 것

Q) 메모리 시장 내 오토모티브 시장 중요도 증가 중. 향후 전망과 준비 상황

전기차, 자율주행차 시대 도래로 차량용 메모리 수요도 강세 중. 오토메모리 시장은 향후 5년간 금액 기준 매년 30% 중후반 성장 보일 것으로 예상. 2030년 초에는 PC 응용보다도 더 큰 사업 기회가 될 것으로 판단해 경쟁력 강화 지속 중
특히 사람 생명과도 직결되는 만큼 신뢰도와 안정성 확보에 집중. 오토모티브용 UFS 3.1 제품에 대해 독일 티어 1 업체에서 국내 업체 최초로 인증. 5월에는 CMBS를 통해 다시 한 번 인증 획득

우리 UFS 3.1 제품이 고객사와 인증기관 모두에서 Full Feature에 대한 인증 확보한 것
이번 인증을 통해 차량용 시장에서 요구하는 높은 수준의 안정성과 품질 수준을 국제적으로 공인 받았다고 할 수 있음
또한 오토모티브 메모리 소비전력 개선을 위한 지속적 개발 중. 이달 초 양산 시작한 UFS 3.1은 업계 최저 수준의 소비전력 보유. 전기차, 자율주행차의 최적의 메모리 솔루션이 될 것으로 기대

지난 8년간 단 한번의 공급 이슈 없이 주요 고객들과의 신뢰 쌓았음. 메이저 Tier-1 OEM 업체에 진입한 상황

Issue Comment

Q) 클라우드, AI 성장으로 메모리 기술 여건 까다로워 지는 중. 수익화하기 위해 어떤 기술 분야에 중점을 두고있나?

서버와 그래픽 응용 포함한 다양한 응용에서 메모리 시장 요구 빠르게 변화 중. 여러 분야에서 미래 기술 확보해 나가고 있음. 데이터센터 AI 에 필요한 32Gb D5 제품 출시할 예정. 하이코어 CPU 는 기존 대비 더 큰 메모리 용량과 대역폭 요구. 한 채널에 여러 디램 모듈 쓰는 것 보다 한 개의 고용량 제품을 쓰는게 효과적. 고용량에 대한 시장 니즈 커지는 중. 32Gb D5 연내 출시해 고용량 모듈을 통해 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 적극 대응할 것

GDDR 에서도 업계 최고 수준의 제품 지속 확보 중. 얼마전 업계 최초 32Gbps GDDR7 개발. GDDR6 대비 1.4 배 데이터속도 빠르고, 20% 전력효율 향상. GDDR7 이 PC 와 게이밍 뿐 아니라 고성능 컴퓨팅, AI 에 폭넓게 사용될 것으로 기대

온디바이스 AI 에 특화된 제품 LLW 디램도 개발 중. 현재 생성 AI 가 서버 기반으로 발전 중이지만, 효율성, 보안 위해 온디바이스 AI 도 확대 중. 저지연, 저전력 특성과 함께 LPDDR 대비 월등히 높은 고대역폭 보유해 기기 생성 데이터 실시간 처리 가능. 이와 연계해 업계 주요 파트너들과 개발 중. 24년 말 양산 목표

데이터센터 AI 에 특화된 메모리와 로직을 바로 결합할 수 있는 제품 개발 중. SRAM 대비 경제적이고, 더 큰 용량 가능. 주요 CPU 업체와 협의 후 제품 상세 스펙 이미 완료했음

LPDDR 기반 모듈인 LPCAM 도 개발. 주로 모바일 단품으로 쓰였지만, 최근 주요 클라이언트 PC, 서버에도 LPDDR 채용해 전력소모 줄이려는 니즈 발생 중. 24년 상반기 시제품 양산, 하반기 시장 대응할 것

초거대 AI 모델 처리에 적합한 HBM-PIM 과 CXL 기반 프로세스 니어메모리 등 개발도 진행 중
메모리 내 가까이 프로세스를 배치해 CPU 와 메모리 간 데이터 병목현상을 개선할 수 있음
HBM-PIM 적용하면 GPU 가속기 대비 AI 모델 성능 3.4배 향상, CXL 기반 PNM 은 메모리 추가로 GPU 가속기 대비 4배의 용량으로 활용 가능. 스토리지 관점에서도 고용량 수요 증가 중. 대응 위해 내년 초 TLC 기반 64TB 서버 SSD 출시 계획

Issue Comment

Q) 프리미엄 TV라인업 운영 전략과 하반기 전망

QLED, OLED, 초대형 등 프리미엄 제품 수요는 견조할 것. 프리미엄 라인업 다변화 예정
하반기 프리미엄 라인업 Back-bone 인 NEO-QLED 강화, OLED는 88, 77인치 라인업 추가할 것

98 인치는 기존 NEO-QLED에 더해 8K QLED 라인업 추가하고, MicroLED는 89인치 추가할 것
라이프스타일 스크린 제품도 적극 활용해 소비자 니즈 충족시킬 것

Q) MR 디바이스 출시 및 생태계 구축 계획

XR 시장을 성장 기회가 큰 신사업으로 보고 있음
핵심 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 등 생태계 구축 위해 체계적으로 준비 중
여러 파트너사와 긴밀한 협력 중. 구글, 퀄컴 등과 협력 지속하고 있음
갤럭시만의 혁신 디바이스 개발하고, 차별화 된 사용자 경험 제공 위해 선제적 투자 중

Issue Comment

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도